



## “Jisso”に思う

野上 義生\*

10年前に私がこの業界に入るきっかけになったのが“Jisso”という言葉であった。その日本語が英語圏で通用することに誇りをもって、営業活動をしていたことを懐かしく思い出します。

当時はワイヤボンディングの時代の最盛期でありましたが、その接合ピッチが100 $\mu\text{m}$ を切ることが難しいと考えられており、必ずフリップチップ化することを予測して装置、プロセスを開発してきました。現実的には既存技術は頑張り続け、20 $\mu\text{m}$ ピッチであろうと可能であり、多段ワイヤ技術まで量産に使われています。

さて、この“Jisso”の言葉ですが、最近この言葉を目にする機会が少なくなり、代わりに“Packaging”“Interconnection”に変わってきています。ここ数年でようやく各種工法でのフリップチップ化が実現し、TSVなどの三次元実装が本格化してきました。しかしながら量産技術では海外のお客様からの発表が増加してきており、その量産の効果が報告されています。今なら基板技術、材料技術、プロセス技術、そして実装装置の総力を挙げた取り組みが実現すれば再度日本の優位性を誇れる時期ではあります。

現在、日本が本当の意味で優位に稼げるデバイス、アプリケーションが減少しつつありますが、日本発の部品内蔵基板、三次元積層デバイス、サーマルマネジメントを駆使したパワー半導体実装など国内で稼げる事業を残したいと強く願っています。

また私が所管する大会事業では4つの事業があります。

1. 国際会議 (ICEP) を通じて海外との交流を進めており、今年4月開催も300名を超える参加者がありました。
2. 9月12日～13日大阪府立大学での秋季大会MESでは新たな企画でのセッションを準備しております。
3. 10月18日～19日に開催される恒例の2012ワークショップ（修善寺）はナイトセッションでの交流が若手技術者の交流の場となっています。
4. 2013年3月13日～15日東北大学で開催される春季講演大会は企業のもの作り技術紹介もあり、学術のみならず実践的な講演を行っています。

エレクトロニクス実装学会では大会事業を通じて日本の実装技術をさらに高める論文を募集し、皆様の活発な発表を期待しております。これから数十年？孫子の時代に“Jisso”の種を残したいと考えています。